

PRO 650 Sputtering

Cryofox PRO 650 Sputtering — это высокопроизводительная высоковакуумная установка для осаждения тонких пленок.

Cryofox PRO 650 Sputtering — это система для серийного производства, предназначенная для частичного или полного покрытия поверхности 3D изделий, полученных литьевым прессованием.

Металлические и неметаллические покрытия наносятся с целью защиты декоративной отделки, защиты от ЭМП и для ЭМС, создания барьерной защиты или антидиффузионного слоя.

Использование осаждения DC/RF распылением или термическим испарением позволяет наносить на изделия различные металлические и неметаллические покрытия.

PRO 650 Sputtering используется в различных отраслях материального производства, небольших и среднего размера автомобильных производствах, производстве изделий электроники и литьевом прессовании.

Модели PRO предназначены специально для напыления масочных и безмасочных покрытий на пластмассовые изделия, в том числе плоские, полученные литьевым прессованием.



В моделях PRO используются горизонтальные цилиндрические камеры.

Все системы Cryofox легко интегрируются в среду чистых комнат.

Все системы Cryofox разрабатываются, проектируются и изготавливаются компанией Polyteknik AS.

Конструкция

- Камера из нержавеющей стали (по запросу: электрохимически полированная сталь)
- Объем камеры: 350 л
- Макс. размер маски: Ø540 x 720 мм
- Вращение инструмента с регулируемой частотой
- Орбитальный механизм для нанесения 3D-покрытия на изделия
- Габаритные размеры:
Вакуумный модуль:
1004 мм X 1008 мм X 1848 мм (Г x Ш x В)
Модуль управления:
1044 мм X 624 мм X 1848 мм (Г x Ш x В)

Обеспечение процесса

- Безмасляный насос для низкого вакуума
- Крионасос для высокого вакуума
- Один или несколько регуляторов массового расхода для подачи газа
- Водяное охлаждение

Контроль процесса

- Полностью автоматический контроль технологического процесса
- Полностью автоматическое или ручное управление системой
- Очень удобный интерфейс управления системой на основе надежного ПЛК-управления
- Контроль и управление системой через Интернет (дополнительно)
- Система протоколирования данных (дополнительно)
- Анализатор остаточных газов и ПК для протоколирования (дополнительно)

Процесс

- DC/RF магнетроны – прямоугольные (2 шт.)
- Резистивный испаритель (дополнительно)
- Плазменная очистка (травление)
- Модуль нанесения основного и верхнего покрытия PECVD технологией (дополнительно)

Дополнительное оборудование

- Чиллер (по запросу)
- Тележки для перемещения инструмента

